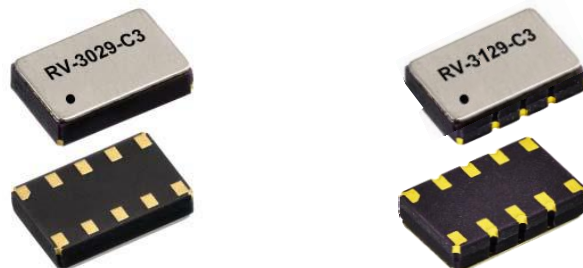


従来のセラミックパッケージC3に側面電極パッケージ品ができました(側面接続)



従来のパッケージ

RV-3029-C3

RV-3049-C3

新パッケージバージョン

RV-3129-C3

RV-3149-C3

側面の電極により検査の際、目視しやすい半田接続が得られます。
半田付けの際、小さいフィレットが生成されます。

新パッケージ品は電気特性およびソフトウェア上の動作、他の特性も従来品と同一です。
よって従来品からの変更で電気特性等の検証は必要ありません。

新パッケージ品は従来品と同様 AEC-Q200に適応します。

新規の設計についてはRV-3129-C3 (I²C-bus) RV-3149-C3 (SPI) のご検討をお勧めします。

RV-3029-C3 , RV-3049-C3 も生産中

新C3 パッケージについて

